



**关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
申请文件的第三轮审核问询函的回复**

保荐人（主承销商）



（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二一年十二月

深圳证券交易所：

根据贵所 2021 年 12 月 10 日下发的《关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第三轮审核问询函》（审核函〔2021〕011355 号）（以下简称“问询函”）的要求，深圳市唯特偶新材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“唯特偶”）会同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”）、发行人律师广东华商律师事务所（以下简称“发行人律师”）、申报会计师天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提到问题逐项进行了落实，并完成了《关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第三轮审核问询函的回复》（以下简称“问询函回复”）。

如无特别说明，本问询函回复中的简称和名词释义与招股说明书中的含义一致，涉及对申请文件修改的内容已用楷体加粗标明。

在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

本问询函回复所用的字体：

黑体加粗	问询函所列问题
宋体	对问询函所列问题的回复，中介机构的核查意见
楷体加粗	涉及修改招股说明书等申请文件的内容

目 录

问题 1. 关于创业板定位及成长性	3
问题 2. 关于行业分类准确性	19
问题 3. 关于期后经营情况	24

问题 1.关于创业板定位及成长性

申请文件及问询回复显示：

(1) 发行人主要产品包括锡膏、焊锡丝、焊锡条等微电子焊接材料以及助焊剂、清洗剂等辅助焊接材料；发行人所处行业内主要国内企业整体经营规模较小。

(2) 报告期各期，发行人研发费用为 1,971.56 万元、2,137.43 万元、2,072.61 万元、909.27 万元，占营业收入比例为 4.22%、4.12%、3.51%及 2.60%，研发费用逐年降低；截至 2021 年 6 月 30 日，公司共有研发及技术研发人员 57 名，占公司员工人数的 15.53%，其中核心技术人员共 2 人，分别为总经理唐欣和研发总监吴晶。

(3) 报告期各期发行人营业收入为 46,716.26 万元、51,821.69 万元、59,080.16 万元及 34,979.16 万元，2018 年至 2020 年公司营业收入的复合增长率为 12.46%。

请发行人说明报告期内研发费用占比逐年下降的原因及技术储备情况，结合各类产品的核心竞争力、技术先进性及技术壁垒、行业未来发展方向、市场成长空间、行业内研发投入情况等，详细分析并说明自身的创新、创造、创意或其中某一项特征。

请保荐人发表明确意见，并针对性地分析发行人是否符合创业板定位。

【回复】：

一、发行人补充说明及保荐人分析

(一) 报告期内公司研发费用占比逐年下降的原因及技术储备情况

报告期内，公司研发费用及占营业收入的比例情况具体如下：

单位：万元

项目	2021 年度（注）	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
研发费用	2,660.00	872.81	2,004.48	2,070.14	1,935.53
营业收入	83,680.97 至 85,480.97	34,979.16	59,080.16	51,821.69	46,716.26
占比	3.11%至 3.18%	2.50%	3.39%	3.99%	4.14%

注：2021 年数据未经审计，为预计数据。

1、最近三年公司研发投入相对稳定，但收入增速较快是公司研发费用占

比呈下降趋势的主要原因

公司通常会依据自身的发展阶段和业务发展战略来制定技术路线、研发项目及研发投入等，一方面既要满足于当年的业务需要，也要有一定的前瞻性为公司长远的发展做技术储备。

公司自 1998 年设立以来已二十多年，从公司的发展阶段来看，公司于 2014 年至 2017 年间，开始针对下游应用领域的多元化进行布局，为此公司持续加大研发投入、扩大研发团队，公司的配方开发能力、生产工艺控制能力和分析检测及产品应用检测能力得到突飞猛进的发展。在此期间，公司先后推出粉固晶锡膏、低温锡膏、喷射专用锡膏、小间距超细粉锡膏、机器人自动焊锡丝、无卤助焊剂等高性能产品，特别是无铅无卤通孔锡膏、环保型电子清洗剂、完全不含卤素水基助焊剂等成为“深圳市重点技术攻关项目”的产品。由此，公司的研发中心分别于 2016 年和 2017 年被评为“深圳市电子焊接材料工程技术研究开发中心”和“广东省电子焊接材料工程技术研究中心”。

随着公司产品体系的逐步完善及核心技术陆续成熟，因此最近三年公司的研发投入相对稳定，2018 年、2019 年和 2020 年公司研发费用分别为 1,935.53 万元、2,070.14 万元和 2,004.48 万元，但最近三年公司营业收入分别为 46,716.26 万元、51,821.69 万元和 59,080.16 万元，公司营业收入的复合增长率为 12.46%。因此，最近三年公司研发投入相对稳定，但收入增速较快是公司研发费用占比呈下降趋势的主要原因。

2、2021 年 1-6 月研发费用占收入的比例下降较大的主要系公司研发活动的特征一般是上半年的投入占比较低，但 2021 年全年研发投入增幅明显

公司的研发活动涉及市场调研、立项开发与管理、技术适配与配方设计、样品试制与检测、工程试制等不同阶段。公司多数研发项目在年初开始立项启动，主要为市场调研和产品设计等工作，因此，通常情况下公司上半年研发费用支出及占比较低，2021 年 1-6 月公司研发费用投入较上年同期对比如下：

单位：万元

项目	2021 年度	2020 年度
研发投入（上半年）	872.81	802.18
研发投入（下半年）	1,787.19（注）	1,202.30

合计	2,660.00	2,004.48
营业收入（注）	83,680.97 至 85,480.97	59,080.16
占比	3.11%至 3.18%	3.39%

注：2021 年下半年研发费用及全年的营业收入数据为预计数据。

从上表可以看出，2021 年 1-6 月研发费用为 872.81 万元较上年同期增长 70.63 万元，增长 8.80%。2021 年全年预计研发费用为 2,660.00 万元，较上年增长 655.52 万元，增幅达到了 32.70%。2021 年，为了进一步提升技术水平，公司加大了研发投入力度，重点加强了在软钎焊膏、无导线 LED 专用锡膏、细间距用 5#粉低温锡膏等领域的研发。经过上半年完成市场调研和产品设计等工作后，下半年进行大量且高频次的样品试制与检测、工程试制等环节，研发投入按预期项目计划逐步实施，预计全年研发费用 2,660.00 万元，公司全年研发投入增幅明显，2021 年公司研发费用占营业收入的比例预计在 3.11%至 3.18% 间。

3、公司研发费用占收入比例处于同行业可比公众公司的中间水平

报告期内，公司研发投入情况与同行业可比公众公司对比情况如下：

公司名称	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
锡业股份	0.17%	0.31%	0.34%	0.34%
升贸科技	1.00%	1.28%	1.38%	1.47%
晨日科技	6.36%	9.65%	7.15%	6.18%
长先新材	5.26%	5.55%	6.66%	7.61%
格林达	2.82%	3.63%	3.97%	3.72%
同行业平均	3.12%	4.08%	3.90%	3.86%
唯特偶	2.50%	3.39%	3.99%	4.14%

说明：数据来源于同行业可比公众公司公开披露的年度数据和半年度数据。

从上表可以看出，报告期内公司研发费用率分别为 4.14%、3.99%、3.39% 和 2.50%，同行业可比公众公司研发费用率平均水平为 3.86%、3.90%、4.08% 和 3.12%，公司研发投入占营业收入比重处于同行业可比公司中间水平，且与同行业平均水平大体相当。

4、公司高度关注行业发展方向，做了大量的研发投入和技术储备

伴随着电子元器件小型化、轻薄化、低成本化以及工业生产日趋环保化的发展趋势，下游终端应用领域对微电子焊接材料的性能、工艺等提出了更高的要求，促进了微电子焊接材料核心技术向产品的精细化、绿色化、低温化方向发展。

为巩固并增强公司的核心技术竞争优势，公司已建立了较为完善的技术研发创新体系，除现有技术工艺、产品持续研发改进外，公司高度关注微电子焊接材料前沿技术的发展动态，并持续加大新技术、新产品的研发力度，截至本问询回复出具日，公司正在进行的主要研发项目如下表所示：

研发项目名称	进展情况	拟达到目标以及技术特点	技术方向	预算投入 (万元)
低固含高活性助焊剂研发	小样试制	助焊剂活性高、去除氧化物能力强、固含低、焊后残留少	绿色化、精细化	450.00
无导线 LED 专用锡膏	批量出货	改善无导线 LED 产品回流焊接中容易出现偏移、立碑、短路、虚假焊等不良。锡膏具有很强的润湿能力和极强的校正能力。	精细化	350.00
细间距用 T5 粉低温锡膏	小批量出货	解决细间距锡膏的印刷、下锡能力、超细锡合金粉焊接时的锡珠现象、提高低温锡膏的绝缘阻抗、力学性能。	低温化、精细化	400.00
水基中性 PCBA 清洗剂	批量出货	快速清洗焊后 PCBA 残留的助焊剂、锡膏焊后残留物。由去离子水、复合型表面活性剂、拓展剂、脱脂剂、缓蚀剂等复配而成，清洗力强与 PCBA 兼容性好，不含卤素符合相关环保法规要求。	绿色化	300.00
高性能 5G 电子器件特种锡膏研发及其产业化	小样试制	提高 5G 电子器件可靠性，如焊接空洞、锡膏粘着力、上锡性能、扩展率、绝缘阻抗等综合性能	精细化	300.00
环保零卤素无铅锡丝	小样试制	在不改变焊接性能的前提下去除卤素添加至完全不含卤素，飞溅性能优越、润湿力强	绿色化、精细化	350.00

（二）结合各类产品的核心竞争力、技术先进性及技术壁垒、行业未来发展方向、市场成长空间、行业内研发投入情况等，详细分析并说明自身的创新、创造、创意或其中某一项特征，说明公司符合创业板的定位

1、公司符合《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条的规定

《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条规定：“属于中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》中下列行业的企业，原则上不支持其申报在创业板发行上市，但与互联网、大数据、云计算、自动化、人工智能、新能源等新技术、新产业、新业态、新模式深度融合的创新创业企业除外：

1、农林牧渔业；2、采矿业；3、酒、饮料和精制茶制造业；4、纺织业；5、黑色金属冶炼和压延加工业；6、电力、热力、燃气及水生产和供应业；7、建筑业；8、交通运输、仓储和邮政业；9、住宿和餐饮业；10、金融业；11、房地产业；12、居民服务、修理和其他服务业。”

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司从事的行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据《国民经济行业分类和代码表》（GB/T4754-2017），发行人所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”大类下的“C398 电子元件及电子专用材料制造”种类，具体细分为“3985 电子专用材料制造”。因此，公司所处行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条“负面清单”规定的行业。

2、公司符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第三条及《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第二条的规定，属于成长型创新企业

根据《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第三条及《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第二条，创业板定位于深入贯彻创新驱动发展战略，适应发展更多依靠**创新、创造、创意**的大趋势，主要服务**成长型创新创业企业**，并支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。

公司属于成长型企业，具备较好的成长性，主要体现在以下几个方面：

（1）业绩持续增长证明了公司具备较好的成长性

2018年、2019年、2020年及2021年1-6月，公司的营业收入分别为46,716.26万元、51,821.69万元、59,080.16万元和34,979.16万元。2018年至

2020 年公司营业收入的复合增长率为 12.46%，2021 年上半年公司营业收入同比继续增长 56.73%，因此公司报告期内的业绩保持了较高的成长性。

同时，公司 2021 年第三季度业绩及全年的业绩预测情况也体现了公司的成长性具有延续性。根据天职国际出具的《审阅报告》，2021 年 1-9 月，公司营业收入 58,338.32 万元，同比增长 48.35%。经初步测算，公司预计 2021 年全年营业收入超过 8.3 亿元，同比增长超过 40%。因此，业绩持续增长证明了公司具备较好的成长性。

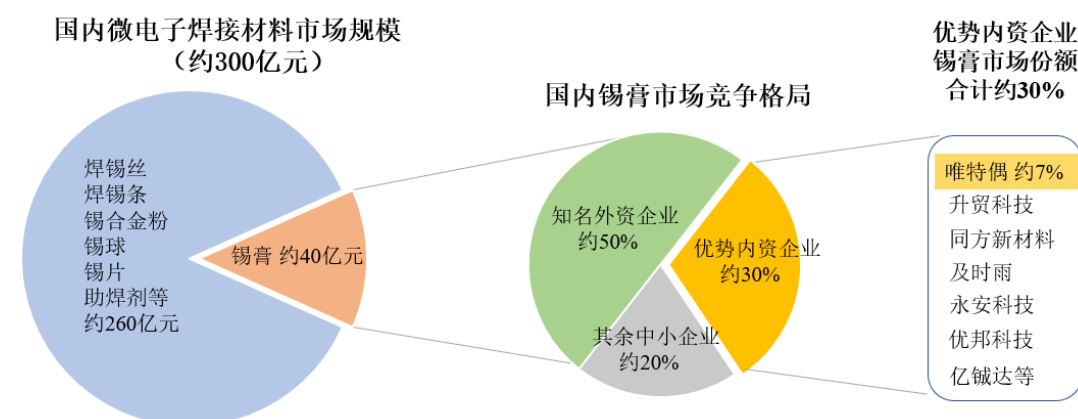
（2）公司作为行业内领先企业，业绩增速高于行业增速

根据中国电子材料行业协会锡焊料材料分会出具的文件显示，锡膏细分市场，2020 年会员单位锡膏产量为 1.24 万吨，同比增长约 10%；焊锡丝、焊锡条细分市场，2020 年会员单位产量合计 11.08 万吨，同比增长 4.14%；助焊剂细分市场，2020 年产量为 3.85 万吨，同比增长 10%。

2019 年和 2020 年连续两年在国内锡膏市场产销量排名第一，公司作为行业内领先企业，2018 年至 2020 年公司营业收入的复合增长率为 12.46%，业绩增速高于行业增速。

（3）广阔的市场为公司保持较高成长性提供了空间

根据中国电子材料行业协会锡焊料材料分会出具的文件显示，2020 年，我国微电子焊接材料总体市场规模约为 300 亿元。公司 2020 年的营业收入为 5.9 亿元，广阔的市场为公司保持较高成长性提供了空间。



说明：“唯特偶约 7%”是指唯特偶目前在国内锡膏市场的份额约 7%。

以公司的核心产品锡膏为例，公司 2020 年锡膏销售规模为 2.63 亿元，与国内锡膏市场的整体规模 40 亿元相比，尚有几十亿规模的增长空间。

(4) 优质的客户资源是公司保持较高成长性的重要基础

①保持与核心客户的长期良好合作关系是业绩增长的重要基础

公司主要客户基本为行业内知名大中型企业，该类企业对于供应商的选择标准比较高、验厂周期比较长，对于合格的供应商通常不轻易更换，并且公司与该类企业已合作多年。如公司与富士康、中兴通讯、海尔智家、普联技术等客户的合作时间超过十年，部分客户如冠捷科技的合作时间甚至超过二十年。公司与报告期内的前十大客户合作历史如下：

序号	客户名称	合作历史	序号	客户名称	合作历史
1	冠捷科技	2000 年开始合作	9	嘉兴市特航新材料有限公司	2015 年开始合作
2	富士康	2008 年开始合作	10	东莞迅诚电业有限公司	2011 年开始合作
3	奥海科技	2015 年开始合作	11	浙江佳明天和缘光伏科技有限公司	2012 年开始合作
4	中兴通讯	2002 年开始合作	12	TP-LINK（普联技术）	2000 年开始合作
5	强力巨彩	2016 年开始合作	13	雷松科技	2013 年开始合作
6	海尔智家	2003 年开始合作	14	深圳市唯创兴电子材料有限公司	2016 年开始合作
7	深圳市维佳海象科技有限公司	2012 年开始合作	15	广东高标电子科技有限公司	2011 年开始合作
8	赛尔康	2007 年开始合作	16	深圳特发东智科技有限公司	2011 年开始合作

得益于下游客户业务规模的持续增长，公司的业务规模也保持快速增长。公司报告期内前十五大客户中有九家上市公司如冠捷科技、中兴通讯、奥海科技、贝仕达克等，其 2018 至 2020 年平均的收入复合增速为 10.10%，2021 年上半年平均收入增幅同比达到 36.04%。

②公司对知名客户仍有非常大的业务提升及拓展空间

尽管公司客户数量众多、遍布多个行业，但在下游行业中仍存在较多的并未被公司开发的知名企业，且仍有大部分的市场份额是掌握在知名外资企业手中。以公司业务量相对较大的消费电子、LED、智能家电、通信、计算机、光

伏、大中型 EMS 工厂为例，公司已成交的代表性客户、储备或待开发的代表性客户情况如下：

主要领域及产品		已成交的代表性客户	储备或待开发的代表性客户
消费电子	手机	中兴通讯、传音控股、摩托罗拉、联想等	苹果、三星、华为、荣耀、小米、VIVO、OPPO 等
	笔记本/平板/台式电脑、PC 显示器	戴尔、惠普、冠捷科技、台湾仁宝等	联想、微星、技嘉、三星、小米、华硕、京东方等
	服务器	浪潮	戴尔、惠普、联想、华为、超微、新华三、思科等
	电源、充电器、耳机、音响等	奥海科技、赛尔康、雷松、欧陆通等	拜亚动力、森海塞尔、JBL、博世、铁三角、捷波朗、苹果、哈曼卡顿、台达、航嘉电子等
光伏		晶科科技、晶澳科技、天合光能、东方日升、爱康科技、阳光电源、古瑞瓦特等	阿特斯、隆基、锦浪科技、上能电气、华为、Solaredge、固德威、特变电工等
通信		中兴通讯、普联技术、华为、灿勤科技、摩比、艾孚、京信、国人、共进股份、福日电子等	思科、华为、诺基亚、爱立信、浪潮、新华三、腾达、水星、小米、斐讯、烽火通信、通宇、东山精密等
LED		强力巨彩、利亚德、山西高科、艾比森、欧曼科技、洲明科技、木林森、欧普照明等	三星、飞利浦、欧司朗、达科电子、上海三思、松下等
智能家电		海尔智家、格力电器、奥克斯、四川长虹、创维集团、格兰仕、康佳集团、伊莱克斯等	美的集团、方太、三星、索尼、LG、松下、夏普、西门子、科勒、飞利浦、惠尔浦、博世、戴森、尚克宁家、霍尼韦尔等
大中型 EMS 工厂		富士康、比亚迪、卓翼股份、光弘科技、捷普、长城开发、台湾仁宝、山水电子、立讯精密等	纬创智通、伟创力、和硕、新美亚、天弘、贝莱胜、名幸电子、新加坡创业、美资旭电、广达、英业达等

虽然公司已成功向部分大型知名企业如富士康、华为等供货，但公司与该等客户尚有较大的业务拓展空间。例如富士康微电子焊接材料的年采购额约 10 亿元，公司仅占其采购额的 2%-3%（以上数据来源于富士康访谈笔录）。又以华为为例，公司研发的低温无铅锡膏、超细粒度锡膏、水溶性锡膏、低温焊锡丝、水基型清洗剂已通过华为认证并有小批量供货，未来的业务合作空间较大。

③配套知名客户的海外市场为公司保持高成长性提供了机遇

报告期各期，公司外销业务占收入的比例分别为 0.40%、0.65%、1.08%和 1.88%，外销业务占收入的比例较低。公司通过了部分大中型客户如冠捷科技、富士康、天合光能等的全球供应商认证并被要求全球配套供应，但受限于资金、产能不足等因素，公司目前仅向其国内生产基地供货。随着募集资金投资项目的建设，公司产能不足问题得以解决，在配套供应客户国内市场的同时，将进一步拓展海外市场，从而满足客户的海外配套供应需求。

公司部分大中型客户业务遍布全球市场。以富士康为例，根据公开数据，其海外生产基地的业务占全球业务量的 1/3 左右。由此可见，除国内市场外，公司在海外市场也具有很大发展空间。知名客户的海外市场也为公司保持高成长性提供了机遇。公司部分客户的境内外生产基地的情况如下表所示：

代表性客户	国内生产基地及服务网点	海外生产基地及服务网点
冠捷科技	厦门、北京、武汉、青岛等	泰国、俄罗斯、波兰、巴西、墨西哥等
富士康	深圳、佛山、郑州、武汉、烟台、重庆等	美国、墨西哥、巴西、印度、越南等
天合光能	常州、北京、上海、义乌、宿迁、盐城等	泰国、越南、美国等

（5）公司积极布局光伏、5G 通信、新能源汽车等行业是公司业绩保持较高增速的重要因素

除在传统的消费电子、智能家电领域进行了深入的布局外，近年来公司把握市场热点，积极拓展光伏、5G 通讯、新能源汽车等行业。以光伏行业为例，报告期内公司对天合光能、晶科科技、晶澳科技等代表性客户的销售额逐年增加，从 2018 年的 278.14 万元增至 2020 年的 1,425.59 万元，复合增速为 126.39%。

2021 年上半年，公司对光伏、5G 通信、新能源汽车等行业的代表性客户销售增长势头得以延续，具体交易情况如下：

单位：万元

下游行业	代表性客户	2021 年 1-6 月	2020 年 1-6 月	增幅
光伏	晶科科技、晶澳科技、天合光能、东方日升、爱康科技、阳光电源等	862.38	425.14	102.85%

5G 通信	中兴通讯、普联技术、华为、灿勤科技等	1,905.25	759.72	150.78%
新能源汽车	比亚迪、长城汽车等	249.16	13.91	1,691.23%

2021 年上半年，公司向光伏、5G 通信和新能源汽车行业代表性客户销售收入同比分别增长 102.85%、150.78%和 1,691.23%。公司抓住了光伏、5G 通信、新能源汽车行业的发展机遇是公司业绩保持较高增速的重要因素。

(6) 进口替代趋势为公司保持高成长性提供了有利的市场环境

在近几年中美贸易战的背景下，国家加大了对高科技行业尤其是集成电路、新材料等行业的扶持。在此背景下，以华为、中兴通讯、海康威视等为代表的国内科技企业为防止关键技术或材料受制于国外供应商，保证供应链的安全稳定，已开始遴选和扶持国内优秀微电子焊接材料供应商，加快产品的进口替代。公司作为国内微电子焊接材料的领先企业之一将因此受益，进而带动业绩持续增长。

此外，公司也具备进口替代的技术实力。以通讯行业为例，公司在应用于 5G 通讯领域的高性能电子器件锡膏研发方面已有较大突破，公司研发的 305 型号锡膏产品在中兴通讯与工业和信息化部电子第五研究所（中国赛宝实验室）共建的“高可靠性微电子装备国产焊膏”研制工程的测试结果中被认定为“达到了国际一流质量水平，可以替代国外受测试品牌锡膏”。

因此，国内的进口替代趋势为公司保持高成长性提供了有利的市场环境。

公司属于创新型企业，具备创新特征，主要体现在以下几个方面：

(1) 公司主营业务符合战略性新兴产业发展方向

公司所处行业为微电子焊接材料行业，主营业务为微电子焊接材料的研发、生产及销售，主要产品包括锡膏、焊锡丝、焊锡条等微电子焊接材料以及助焊剂、清洗剂等辅助焊接材料。根据国家发展和改革委员会 2017 年 1 月发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）版》，公司产品属于“1.3.5 关键电子材料”之“新型电子元器件材料”。根据 2020 年 9 月国家发改委、工信部、财政部、科技部等四部委联合下发的《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》要求围绕微电子等重点制造领域加快在电

子封装材料等领域实现突破，公司产品作为用于电子元器件的组装和电子电路互联的重要基础材料，属于“电子封装材料”。

因此公司主营业务符合战略性新兴产业发展方向，符合“深入贯彻创新驱动发展战略”的创业板定位。

（2）公司以技术为先导，产品具备较强的核心竞争力

公司深耕微电子焊接材料二十余年，拥有较强的技术创新能力，是本行业国家标准及行业标准的主要起草者，主导或参与了《电子装联高质量内部互连用助焊剂 GB/T 31474-2015》、《软钎剂分类与性能要求 GB/T 15829-2008》、《电子装联高质量内部互连用焊锡膏 GB/T 31475-2015》等 7 项国家标准及《无铅焊接用助焊剂 SJ/T11389-2019》、《焊锡膏通用规范 SJ/T11186-2019》等 7 项行业标准的制定或修订。作为行业内的领先企业，公司拥有较强的技术创新能力，体现在产品配方开发能力、生产工艺控制能力、分析检测及产品应用测试能力等多个方面，逐步形成了行业领先的集产品配方研发、生产过程控制、质量检测于一体的技术创新体系。

公司较强的技术创新能力使得公司产品具备较强的核心竞争力。公司产品创新获得了多项荣誉，其中电子工业用焊膏、免清洗无铅焊料助焊剂、完全不含卤素免清洗无铅焊料助焊剂等产品被科技部、商务部等四部委联合评定为“国家重点新产品”；无卤素低固含水基免清洗助焊剂、免清洗无铅焊料助焊剂是“国家火炬计划项目”；无铅无卤免冷藏锡膏、无铅无卤通孔锡膏、机器人自动焊接用不断芯焊锡丝、高拉力光伏组件用无卤助焊剂等十多个产品被广东省高新技术企业协会评为“广东省高新技术产品”。

公司产品具备较强的技术实力，根据深圳科技创新委员会公示名单，公司主导的高性能电子器件锡膏研发及其产业化项目获得 2021 年度深圳市科学技术奖科技进步（技术开发类）一等奖。公司研发的 305 型号锡膏产品在中兴通讯与工业和信息化部电子第五研究所（中国赛宝实验室）共建的“高可靠性微电子装备国产焊膏”研制工程的测试结果中被认定为“达到了国际一流质量水平，可以替代国外受测试品牌锡膏”。

（3）公司部分核心技术水平已处于较高水准，并形成了一定的技术壁垒

通过多年的研发创新，公司整体技术水平已处于较高水准，公司在产品配方、工艺控制、分析检测及产品应用检测等方面形成了多项核心技术，核心技术先进性、技术壁垒的具体情况如下：

序号	技术种类	技术名称	技术先进性及具体表征	技术壁垒
1	产品配方 相关技术	免冷藏锡膏技术	公司研发及技术人员通过对锡膏配方进行调整升级，包括合金成分和助焊剂成分微调，提高锡膏在常温下的稳定性，极大降低了运输过程中因制冷不良而导致的产品质量风险，同时延长了产品的使用寿命，具有很大的实用价值	形成《一种免冷藏焊锡膏及其制备方法》专利；该技术是高性能电子器件锡膏研发及其产业化项目应用的核心技术之一（注）
2		超细粉锡膏技术	超细粉锡膏的主要技术难点在于超细锡合金粉和助焊膏的匹配性，公司成功突破这一技术，采用超细锡合金粉如 7#粒径制备锡膏，主要应用于超细间距元件，更细小元件的焊接，锡膏具有优越的印刷性能及焊后低空洞、高可靠性的特点	-
3		零卤锡膏技术	传统的锡膏降低卤素含量后，锡膏的焊接性就会受到影响，而公司在完全不含卤素的锡膏中，通过调整配方，保证了锡膏整体焊接性能，有效提高焊后的可靠性	该技术是高性能电子器件锡膏研发及其产业化项目应用的核心技术之一
4		少空洞锡膏技术	锡膏中由于助焊膏的体积占比较大，焊后容易出现大的空洞，公司技术人员通过调整配方，配制成的锡膏具有焊层空洞少、润湿力强、可焊性好、免清洗的优点	形成《一种焊层少空洞的无铅免清洗锡膏及其制备方法》专利；该技术是高性能电子器件锡膏研发及其产业化项目应用的核心技术之一
5		低温锡膏技术	低温锡膏焊点普遍存在韧性差、容易开裂的弊端，通过优化合金成分比例以及助焊膏成分，研制的锡膏性能获得明显提升，熔点较低、强度提升、韧性增强	-
6		水基清洗剂技术	传统的清洗剂大部分采用溶剂型载体，对环境和人体健康都会有不良影响，公司的水基清洗剂区别于传统的溶剂型清洗剂，载体为水，所用各组分均为低毒、不含强碱性物质，不腐蚀钢网，对人体基本无毒害作用	形成《一种印刷钢网用水基清洗剂》专利

序号	技术种类	技术名称	技术先进性及具体表征	技术壁垒
7		光伏组件助焊剂技术	光伏组件用助焊剂，不仅焊接拉力高，而且固态含量低于传统助焊剂，焊接后电池片上基本上没有一点残留，导电率优良，已通过多家知名光伏组件企业测试	形成《一种高拉力光伏组件用助焊剂》专利
8		免清洗助焊剂技术	技术先进性在于该产品免清洗，润湿力强，可焊性优越，焊后板面残留物少，且铺展均匀，表面绝缘电阻高，焊剂的溶剂可用去离子水取代 VOC 溶剂，符合环保要求	形成《免清洗无铅焊料助焊剂》《完全不含卤素免清洗无铅焊料助焊剂》专利
9		水基助焊剂技术	传统的助焊剂为溶剂型载体，该产品用去离子水作溶剂，无须清洗，不含卤素，可焊性好，焊后残留物少，绝缘电阻高，基本不含 VOC 物质，是环保型助焊剂，且不易燃烧	形成《无卤素低固含水基免清洗助焊剂》专利
10	生产工艺技术	助焊膏体碾磨技术	传统的碾磨为单辊碾磨，助焊膏膏体结块碾磨不充分，本技术通过对助焊膏膏体进行多辊碾磨，消除膏体结块，使膏体充分均匀	-
11		自动化真空膏体搅拌技术	该技术的先进性在于通过自动化程序控制腔体真空度，并自动控制膏体搅拌速率以及循环次数，防止焊锡合金粉表面氧化或开裂，可获得质量均匀的锡膏	-
12		超细焊锡丝不断芯技术	超细焊锡丝往往面临断芯的缺陷，影响产品的使用，本技术通过自动化设备加压，结合电脑控制挤压、拉拔速率，使助焊剂药芯实心填充于焊锡丝心部	-
13		低 Ag 无铅锡合金粉制粉技术	目前现有的锡合金粉制粉技术，多数采用离心雾化技术，效率高，但锡合金粉质量差。本技术采用超声波雾化技术制备低 Ag 无铅锡合金粉，产品稳定，一致性好	-
14	分析检测及产品应用检测相关技术	化学元素分析技术	分析焊料中组成元素及微量元素的含量；分析焊料中有害物质元素的含量；测定液态样品在固定相上的分配系数、活度系数、分子量和比表面积等	-
15		焊接微观结构分析技术	通过 SEM 等分析检测设备，结合理论分心，主要针对焊点界面分析，焊点缺陷定位分析，断口分析以及焊接机理研究等	-
16		器件破坏性物理分析技术	主要涉及电性能失效定位，PCB 缺陷定位，器件失效机理研究	-

序号	技术种类	技术名称	技术先进性及具体表征	技术壁垒
17		焊接工艺及来料质量评估技术	主要涉及焊接质量评估, PCB 来料制造工艺评估, 锡膏性能评估, 器件质量评估	-

注: 根据深圳科技创新委员会公示名单, 公司主导的高性能电子器件锡膏研发及其产业化项目获得 2021 年度深圳市科学技术奖科技进步(技术开发类)一等奖。

(4) 公司持续推进自身的技术创新与产业的深度融合, 当前公司在精细化、绿色化及低温化的行业发展方向上已取得一定的技术成果

精细化方面, 公司主要研究小器件焊盘(0.35mmPitch)及超细间距 BGA 的焊接技术, 陆续开发了 T5 锡膏、T6 锡膏。下游客户经过对公司产品在印刷性、可焊性及可靠性等方面的综合评估测试, 认为该产品达到了国外同行先进水平。其中, T5 锡膏已实现批量交付, 已成交的知名客户包括冠捷科技、联想集团、摩托罗拉等; 处于认证阶段的客户包括小米、TCL、阿尔卡特等。公司 T6 锡膏已应用于芯片领域, 已成交的知名客户包括瑞丰光电、聚飞光电、苏州雷霆光电科技有限公司、广东晶科电子股份有限公司等; 长电科技、通富微电子等公司也正在对公司 T6 锡膏进行认证。

绿色化方面, 公司主要研究符合环保要求的产品, 如无卤化锡膏/助焊剂、水基型助焊剂/清洗剂, 该等产品均已经大批量生产和交付。公司研发的 GW9066 型号水基型清洗剂获得了 Clean Production Action¹颁发的 Green Screen 美国绿色金牌认证证书。经查询全球目前仅有两家生产企业的电子工业用清洗剂产品获得该认证, 唯特偶是其中一家², 也标志公司水基型清洗剂达到了国外同行先进水平。

低温化方面, 公司主要研究低温锡膏产品, 该产品可有效降低电子装联环节中的能耗。在华为实验室的测评中, 产品的焊接强度、抗疲劳性和焊接温度

¹ Clean Production Action 是美国权威的第三方非营利环保认证机构, 主要从事工业化学品的环保认证。Green Screen® for Safer Chemicals 是一种化学品危害评估方法, 旨在识别高度关注的化学物质和更安全的替代品, 识别化学品固有危害及其对人类健康和环境的潜在影响。该认证在欧美被工业界、政府和非政府组织以及 Apple、HP、Microsoft 等知名企业广泛应用于支持化学品产品设计和开发, 清洗剂材料采购导入和使用的重要评价依据。

² 目前在清洗剂产品中获得该认证的共两家公司, 除了唯特偶 GW9066 型号的水基型清洗剂外, 还包括德国 Zestron 公司的两款产品。数据来源: <https://www.greenscreenchemicals.org/certified/products>。

等指标均可满足其要求，达到了国外同行先进水平，已经获得华为认证并多次交货。

技术方向	产品名称	产品特征	应用情况
精细化	T5 粒径锡膏	锡粉超细粉径 15-25 μm ，能够满足 0.35mmPitch 及以上超细间距 BGA、QFN/QFP 器件的焊接	主要应用于计算机、通信、消费电子等精细化要求较高的行业
	T6 粉径锡膏	锡粉超细粉径 5-15 μm ，粘度稳定，触变性能良好	适用于芯片封装焊接
绿色化	无卤化锡膏/助焊剂	无卤化锡膏/助焊剂满足环保要求	主要应用于计算机、通信、消费电子等环保要求较高的行业
	水基型助焊剂和清洗剂	载体为水，区别于传统溶剂型产品，环保性能优良	主要应用于焊接及焊接后的清洗工艺
低温化	低温锡膏	以铋基系列合金为主，合金熔点低于传统的无铅合金	主要应用于不耐热的电子元件焊接

（5）公司注重技术创新，研发投入处于同行业可比公众公司的中间水平

公司注重技术创新，持续投入大额资金开展对新产品、新技术的研发活动。报告期内，公司研发投入情况与同行业可比公众公司对比情况详见本问询回复“问题 1”之“一、发行人补充说明及保荐人分析”之“（一）报告期内公司研发费用占比逐年下降的原因及技术储备情况”。

综上所述，公司业绩增长较快，产品和技术实力获得了众多知名客户的认可，公司所处行业市场空间广阔、主营业务和主要产品符合战略性新兴产业发展方，公司还主导或参与了多项国家和行业标准的制定，拥有多项技术储备，产品获得了多项发明专利和荣誉，因此公司具备较好的成长性，具备创新特征，公司属于成长型创新创业企业，符合创业板的定位。

二、保荐人核查并发表明确意见

（一）核查程序

针对上述问题，保荐机构执行了以下核查程序：

1、核查了公司研发立项情况、研发支出台账及明细、审计报告；访谈了研发部经理，核查公司研发体系情况；

2、查阅了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）版》《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》；

3、访谈了发行人研发部门相关负责人，了解了发行人的研发投入情况、技术储备、研发情况、产品技术优势及技术先进性、技术壁垒、未来行业发展方向等情况；

4、访谈了发行人总经理，了解发行人所处行业的成长性、市场空间情况；

5、获取了中国电子材料行业协会锡焊料材料分会出具的《关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司咨询 2020 年市场情况的复函》；

6、查阅了发行人同行业可比公司的公开披露资料，了解了同行业可比公司的研发投入情况；

7、取得了的公司 GW9066 型号的水基型清洗剂获得的 Clean Production Action 颁发的 Green Screen 绿色金牌认证证书；

8、取得了申报会计师出具的公司 2021 年 1-9 月的《审阅报告》；

9、查阅了《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》关于创业板定位的相关要求；

10、查阅了深圳市科技创新委员会关于 2021 年度深圳市科学技术奖的公示名单。

（二）核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、随着发行人产品体系的逐步完善及核心技术陆续成熟，因此最近三年发行人的研发投入相对稳定，但收入增速较快是发行人研发费用占比呈下降趋势的主要原因。2021 年 1-6 月研发费用占收入的比例下降较大的主要系发行人研发活动的特征一般是上半年的投入占比较低，但 2021 年全年研发投入增幅明显。总体来看，发行人研发费用占营业收入比例略有下降，但研发费用总额保持相对持续的增长态势。

2、发行人业绩增长较快，产品和技术实力获得了众多知名客户的认可，发行人所处行业市场空间广阔、主营业务和主要产品符合战略性新兴产业发展方向。发行人还主导或参与了多项国家和行业标准的制定，拥有多项技术储备，产品获得了多项发明专利和荣誉，发行人具备较好的成长性和新特征，发行人

属于成长型创新创业企业，由于发行人所属行业不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条规定的原则上不支持申报的行业类别，因此，发行人符合创业板定位。

问题 2.关于行业分类准确性

申请文件及问询回复显示：

(1) 发行人可比境内上市/挂牌公司中尚无划分为电子元件及电子专用材料制造的企业；创业板在审企业哈焊华通的主要产品为各类熔焊材料，包括焊丝、焊条、焊剂等，其行业分类为“C33 金属制品业”。

(2) 截至目前“C3985 电子专用材料制造”细分行业上市公司中尚无主营业务为锡焊料、辅助焊接材料的公司。

请发行人结合与哈焊华通在原材料、生产过程、应用技术、适用范围、应用场景等方面的比较情况，进一步说明行业划分准确性。

请保荐人、发行人律师发表明确意见。

【回复】：

一、发行人补充说明

企业行业分类是按《国民经济行业分类》作为分类标准和依据，由地方主管部门工业和信息化局认定、地方统计局行业信息登记，并参与相应的行业自律性管理组织协会。

(一) 唯特偶划分行业的产品对象是锡膏，哈焊华通是焊丝

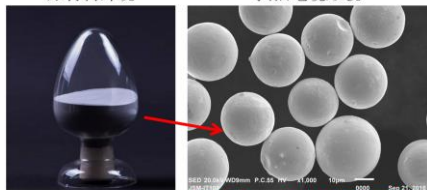
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)第 2.2 条：“当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于 50%，则将其划入该业务相对应的行业”；第 2.3 条：“当上市公司没有一类业务的营业收入比重大于或等于 50%，但某类业务的收入和利润均在所有业务中最高，而且均占到公司总收入和总利润的 30%以上（包含本数），则该公司归属该业务对应的行业类别”确定单位归属的行业。

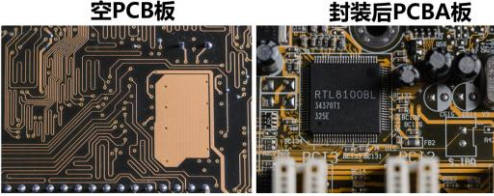
由于唯特偶没有单独一款产品的收入占比超过 50%，因此公司是以**锡膏**作为行业划分的主要产品。报告期内，公司锡膏销售收入和利润的占比均超过总额 40%，且锡膏产品的收入和利润在所有业务中最高。

哈焊华通是以**焊丝**作为行业划分的主要产品，报告期内其焊丝销售收入占比超过 80%。

（二）焊丝与锡膏在原材料、生产过程、应用技术、适用范围、应用场景等方面均存在明显的不同

焊丝与锡膏在原材料、生产过程、应用技术、适用范围、应用场景等多个方面进行比较，双方存在明显的不同，具体如下表所示：

项目	焊丝（哈焊华通）	锡膏（唯特偶）
产品	 焊丝	 锡膏
主要原材料	 盘条-钢材、药粉	原材料外观 扫描电镜形貌  10-40um,放大1000倍图像 锡合金粉、松香、活性剂、触变剂
生产过程	冶炼/熔炼、抛光、拉拔、退火、压涂、烘干、成型等	配料、加热、搅拌、冷却等
应用技术	研究金属材料在高温焊接充填后的焊接强度、抗氧化锈蚀能力等技术	研究锡合金粉与松香、活性剂、触变剂等化学材料的配方技术，解决 PCB 与电子元器件的互联与封装制程中的冷热坍塌、焊接短路、空洞率、电迁移等电子电气性能问题
适用范围	中大型钢、铁等黑色金属工件或同种合金工件的熔焊焊接，主要应用于建筑、桥梁、船舶、管道等领域	电子产品 PCBA 生产制程中的互联与封装，主要应用于消费电子、智能家电、通信设备、计算机等领域

应用 场景	 	 
产品 价格	0.5-1.5 万元/吨	20-50 万元/吨
熔点 温度	900℃以上	300℃以下

从上表可以看出，焊丝和锡膏具有本质的区别，主要体现在以下几个方面：

（1）应用技术方面不同：焊丝研究的是钢材熔焊充填技术，而锡膏研究的是在电子装联环节的电子性能。

（2）适用范围和应用场景方面不同：焊丝主要用于建筑、桥梁、管道等建设中的大型钢、铁等黑色金属工件熔焊焊接；而锡膏主要用于消费电子、智能家电、通信设备等电子产品的导电连接，通过精密印刷、电子元器件贴装、回流焊接等工艺实现 PCB 与各式电子元器件、半导体器件的互联与封装。

（3）产品市场价格差异明显：焊丝的市场价格在 0.5-1.5 万元/吨，锡膏的市场价格在 20-50 万元/吨。

因此，锡膏与焊丝在多个方面均存在本质的不同，二者不可相互替代。

（三）行业自律组织不同

公司加入的行业自律性组织为中国电子材料行业协会及其下属的电子锡焊料材料分会。

哈焊华通加入的行业自律性组织为中国焊接协会和中国机械工程学会焊接分会。

（四）国家标准、行业协会和地方主管部门均证明公司行业属性符合“C3985 电子专用材料制造”

1、国家标准及机构指导产品分类，锡膏属于关键电子材料

根据国家标准《电子装联高质量内部互连用焊锡膏》(GB/T 31475—2015)焊锡膏是用于表面**组装元器件和电子电路互连**时的软钎焊材料。

根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，电子无铅焊料（锡膏）属于“关键电子材料”，目录为“1.3.5 关键电子材料”之“新型电子元器件材料”之“电子无铅焊料”。

在《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)中，“指用于电子元器件、组件及系统制备的专用电子功能材料，**互联与封装材料**、工艺及辅助材料的制造，……”锡膏属于电子专用材料中的互联与封装材料，其行业分类为“C3985 电子专用材料制造”。

2、中国电子材料行业协会证明公司属于“C3985 电子专用材料制造业”

2021 年 10 月 25 日，中国电子材料行业协会出具了《关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司产品行业分类情况说明》：“唯特偶主要生产锡膏、焊锡丝、焊锡条等微电子焊接材料以及助焊剂、清洗剂等辅助焊接材料，产品属于电子元器件及其组件的互联与封装专用材料，主要应用于 PCBA 制程、精密结构件连接、半导体封装等多个产业环节的电子器件的组装与互联。对照《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)及《2017 国民经济行业分类注释》，唯特偶所属行业为《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)的 C3985 电子专用材料制造。”

3、所在地主管部门出具《说明》、《复函》，认为公司属于“C3985 电子专用材料制造行业”

2021 年 4 月 10 日，深圳市龙岗区工业和信息化局到唯特偶现场调研，并于 2021 年 4 月 21 日出具《深圳市龙岗区工业和信息化局关于深圳市唯特偶新材料股份有限公司非高耗能行业企业情况说明》：“深圳市唯特偶新材料股份有限公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业中的电子专用材料制造行业。”

2021 年 11 月 24 日，深圳市统计局到唯特偶现场调研，并于 2021 年 11 月 30 日出具《深圳市统计局关于提供相关企业信息的复函》：“深圳市唯特偶新材料股份有限公司，组织机构代码 192465506，深圳市唯特偶新材料股份有限公

司为我市‘一套表’工业专业企业，行业代码 3985，主要业务活动：生产电子半导体、生产锡制品、生产助焊剂。”

综上所述，锡膏是唯特偶的主要产品，焊丝是哈焊华通的主要产品，是双方进行行业划分的主要依据。唯特偶和哈焊华通在原材料、生产过程、应用技术、适用范围、应用场景等方面有着本质的不同，两公司不属于同一个行业。根据《国民经济行业分类》、《上市公司行业分类指引》、国家标准《电子装联高质量内部互连用焊锡膏》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，以及中国电子材料协会、深圳市统计局、深圳市龙岗区工业和信息化局对公司所处行业情况的回复，公司划分为“C3985 电子专用材料制造”是合理、准确的。

二、保荐人、发行人律师核查并发表明确意见

（一）核查程序

针对上述问题，保荐机构、发行人律师执行了以下核查程序：

1、查询了哈焊华通公开披露的招股说明书、审核问询回复等公开披露资料；

2、查询了《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）、《电子装联高质量内部互连用焊锡膏》（GB/T 31475—2015）、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》；

3、获取了深圳市统计局、深圳市龙岗区工业和信息化局、中国电子材料行业协会等行业主管部门出具的说明。

（二）核查意见

经核查，保荐机构、发行人律师认为：

发行人与哈焊华通的主营业务、主要产品均不同，在原材料、生产过程、应用技术、适用范围、应用场景等方面有着本质的不同，所属的行业自律组织也不同，二者归属于不同的行业。根据《国民经济行业分类》、《上市公司行业分类指引》、国家标准《电子装联高质量内部互连用焊锡膏》、《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》，以及中国电子材料协会、深圳市统计局、

深圳市龙岗区工业和信息化局对公司所处行业情况的回复，发行人所处行业划分为“3985 电子专用材料制造”是合理、准确的。

问题 3.关于期后经营情况

申请文件及问询回复显示，2021 年 1-6 月，发行人微电子焊接材料、辅助焊接材料销售金额分别为 28,946.80 万元、5,665.51 万元，较 2020 年同期分别增长 58.49%、47.37%，销量分别增长 34.42%、44.38%，远高于 2018-2020 年增速水平。

请发行人说明 2021 年 1-9 月业绩情况及 2021 年全年业绩预计情况。

请保荐人、申报会计师发表明确意见。

【回复】：

一、发行人补充说明

公司财务报告审计截止日为 2021 年 6 月 30 日，财务报告审计截止日后公司主要经营状况正常，产业政策、税收政策、行业市场环境未发生重大变化。公司主营业务及经营模式未发生重大变化，董事、监事、高级管理人员未发生变更，也未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。

（一）2021 年 1-9 月公司业绩情况

公司 2021 年 1-9 月财务数据未经审计，但业经申报会计师审阅，并出具了天职业字[2021]46692 号《审阅报告》。公司经审阅的 2021 年 1-9 月主要财务信息如下：

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动比例
资产总计	54,143.91	47,906.25	13.02%
负债合计	19,610.07	16,596.54	18.16%
所有者权益合计	34,533.84	31,309.71	10.30%
归属于母公司所有者权益合计	34,533.84	31,309.71	10.30%

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2021年 1-9月	2020年 1-9月	变动比例	2021年 7-9月	2020年 7-9月	变动比例
营业收入	58,338.32	40,207.49	45.09%	23,359.16	17,888.98	30.58%
营业利润	7,284.21	5,283.72	37.86%	2,932.00	2,868.55	2.21%
利润总额	7,241.58	5,263.57	37.58%	2,929.57	2,862.49	2.34%
净利润	6,253.72	4,652.25	34.42%	2,552.44	2,476.23	3.08%
归属于母公司所有者的净利润	6,253.72	4,652.25	34.42%	2,552.44	2,476.23	3.08%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	5,698.15	4,318.58	31.95%	2,422.13	2,261.02	7.13%

受2020年上半年疫情影响以及2021年公司下游客户采购需求快速增长和公司产品平均销售价格上涨等因素的影响，2021年1-9月，公司营业收入为58,338.32万元，同比大幅增长，增幅45.09%。

2021年7-9月，公司营业收入为23,359.16万元，同比增长为30.58%，但同期相关利润指标增幅明显低于营业收入增幅，主要系原材料价格大幅上涨导致公司2021年7-9月的毛利率较上年同期下降，从而降低了营业利润所致。2021年7-9月公司毛利率为24.65%，而2020年7-9月公司毛利率29.05%，毛利率下降了4.4个百分点。毛利率下降主要是由于主要原材料采购价格上涨导致单位成本上升幅度大于单位售价上升幅度所致。若2021年7-9月的毛利率保持与上年同期一致的情况下，则公司营业利润的增幅与营业收入增幅基本接近，具体测算如下（2021年7-9月营业收入不变的情况下，假设2021年7-9月毛利率与2020年7-9月保持一致）：

单位：万元

项目	2021年7-9月测算数	2020年7-9月	变动比例
营业收入	23,359.16	17,888.98	30.58%
营业利润	3,959.12	2,868.55	38.02%

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2021年 1-9月	2020年 1-9月	变动比例	2021年 7-9月	2020年 7-9月	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,121.75	5,203.51	-121.56%	-638.76	2,136.15	-129.90%

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动比例	2021 年 7-9 月	2020 年 7-9 月	变动比例
投资活动产生的现金流量净额	-239.87	-2,359.92	-89.84%	450.82	-1,040.74	-143.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-22.66	-2,293.65	-99.01%	-162.51	-1,550.71	-89.52%
汇率变动对现金的影响	-28.77	14.66	-296.30%	-13.98	12.23	-214.27%
现金及现金等价物净增加额	-1,413.05	564.60	-350.28%	-364.43	-443.07	-17.75%

公司经营活动产生的现金流量净额主要受“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”影响。2021年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降（即由正转负），主要是公司“购买商品、接受劳务支付的现金”明显增加所致。2021年1-9月公司“销售商品、提供劳务收到的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”具体分析如下：

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月
销售商品、提供劳务收到的现金（①）	45,594.87	31,605.78
营业收入（②）	58,338.32	40,207.49
销售回款比（③=①/②）	78.16%	78.61%
购买商品、接受劳务支付的现金（④）	37,748.43	18,109.88
营业成本（⑤）	43,981.00	28,767.89
采购付款比（⑥=④/⑤）	85.83%	62.95%

通过上表分析可知，公司2021年1-9月的销售回款比例与上年同期基本一致，未发生较大变化，但公司2021年1-9月的采购付款比由上年同期的62.95%增长至85.83%，采购付款比的大幅增长从而导致公司经营活动产生的现金流量净额下降较为明显。公司采购付款比上升主要是由于2021年锡锭等原材料价格持续大幅上涨，公司的采购成本上升以及随着业务的不断拓展公司的营业规模快速增长等所致。不过公司预计2021年全年经营活动产生的现金流量净额为正。

4、非经常性损益主要数据

单位：万元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	2021年7-9月	2020年7-9月	变动比例
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-13.13	-3.8	245.77%	-1.10	-0.88	24.89%
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	475.61	320.68	48.31%	43.51	248.19	-82.47%
委托他人投资或管理资产的损益	8.93	47.74	-81.30%	3.62	12.66	-71.40%
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	109.65	48.3	127.05%	109.65	-	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	114.3	-	-	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40.91	-16.43	149.07%	-1.85	-5.25	-64.73%
非经常性损益合计	654.45	396.49	65.06%	153.83	254.71	-39.61%
减：所得税影响金额	98.88	62.82	57.40%	23.52	39.50	-40.46%
扣除所得税影响后的非经常性损益	555.57	333.67	66.50%	130.31	215.21	-39.45%
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	555.57	333.67	66.50%	130.31	215.21	-39.45%
归属于少数股东的非经常性损益	-	-	-	-	-	-

（二）2021年全年业绩预计情况

公司结合在手订单、已发货待确认收入等因素，经公司初步测算，2021年的业绩预计情况具体如下：

单位：万元

项目	2021年度预计	2020年度	同比增幅
营业收入	83,680.97 至 85,480.97	59,080.16	41.64%至 44.69%

营业利润	9,557.14 至 9,707.67	7,490.33	27.59%至 29.60%
利润总额	9,523.73 至 9,674.26	7,435.23	28.09%至 30.11%
净利润	8,342.00 至 8,473.81	6,523.78	27.87%至 29.89%
归属于母公司所有者的净利润	8,342.00 至 8,473.81	6,523.78	27.87%至 29.89%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	7,742.00 至 7,873.81	5,967.83	29.73%至 31.94%

公司预计 2021 年营业收入为 83,680.97 万元至 85,480.97 万元，同比上涨 41.64%至 44.69%，预计扣除非经常损益后归属于母公司所有者的净利润为 7,742.00 万元至 7,873.81 万元，同比上涨 29.73%至 31.94%，公司经营业绩将继续保持增长态势。目前公司所属行业发展态势良好，主要客户合作情况稳定，在手订单充足，有效保证了公司经营业绩的持续快速发展。本次业绩预计仅为公司对 2021 年度经营业绩的合理估计，并不构成业绩承诺或盈利预测。

二、保荐人、申报会计师核查并发表明确意见

（一）核查程序

针对上述问题，保荐机构、申报会计师执行了以下核查程序：

1、获取发行人 2021 年 1-9 月经营业绩财务报表及相关资料，了解 2021 年 1-9 月业绩情况，并对发行人 2021 年 1-9 月业绩情况和 2020 年同期业绩进行对比分析；

2、获取发行人对 2021 年业绩预测的过程及依据，分析全年业绩预测的合理性；

3、获取发行人在手订单明细，核查在手订单、已发货待确认收入情况，分析 2021 年全年业绩预计营业收入的合理性；获取发行人 2021 年全年业绩预计毛利率情况，分析预计业绩的合理性。

（二）核查意见

经核查，保荐机构、申报会计师认为：审计截止日发行人主要经营状况正常，未发生可能影响投资者判断的重大事项。

经申报会计师审阅，发行人 2021 年 1-9 月的业绩保持稳定增长；结合在手订单、已发货待确认收入等因素，对发行人 2021 年全年业绩进行了合理预计，发行人经营业绩仍将继续保持增长态势。

（本页无正文，为《深圳市唯特偶新材料股份有限公司关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第三轮审核问询函>的回复》之签章页）

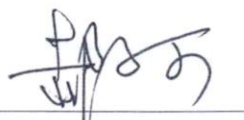
法定代表人： 
廖高兵

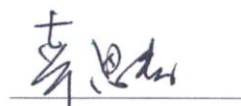
深圳市唯特偶新材料股份有限公司

2021年1月25日

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于<深圳市唯特偶新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第三轮审核问询函>的回复》之签章页）

保荐代表人：


郝为可


辛思春



国金证券股份有限公司董事长声明

本人已认真阅读深圳市唯特偶新材料股份有限公司本次审核问询函的回复报告的全部内容，了解报告涉及问题的核查过程、本公司的内核和风险控制流程，确认本公司按照勤勉尽责原则履行核查程序，审核问询函的回复报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对上述文件的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

董事长：



冉 云

